

Investor Relations 2023

ADVANCED LINK TECHNOLOGY

반도체 분야에서 뛰어난 기술력과 경험을 바탕으로
끊임없이 미래에 도전합니다.



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사에이엘티(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

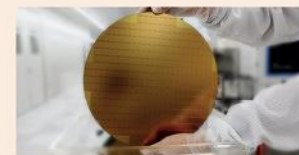
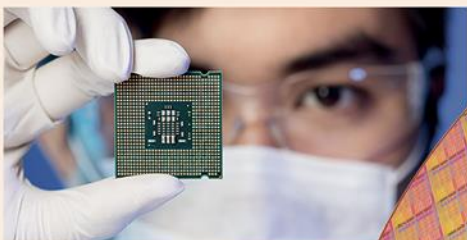
본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.



ADVANCED LINK TECHNOLOGY

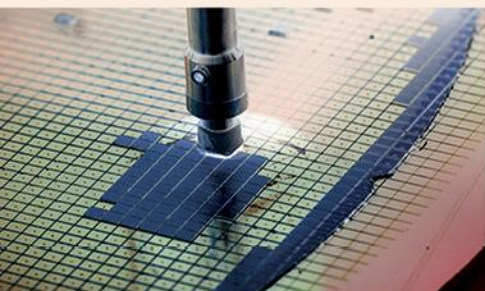
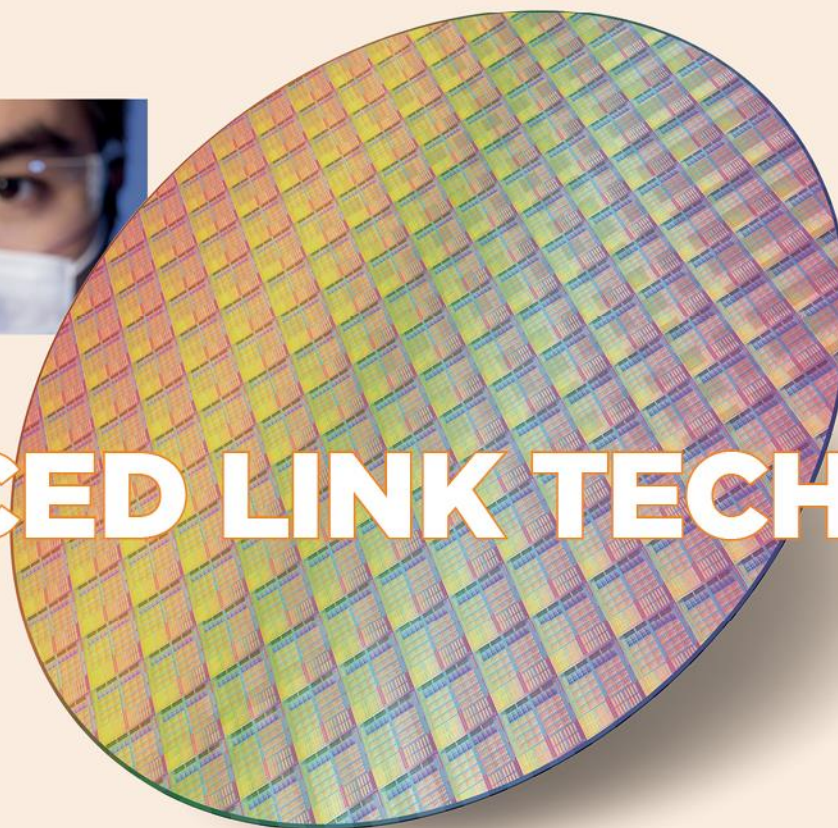


Table of Contents

Prologue

1. Company Overview

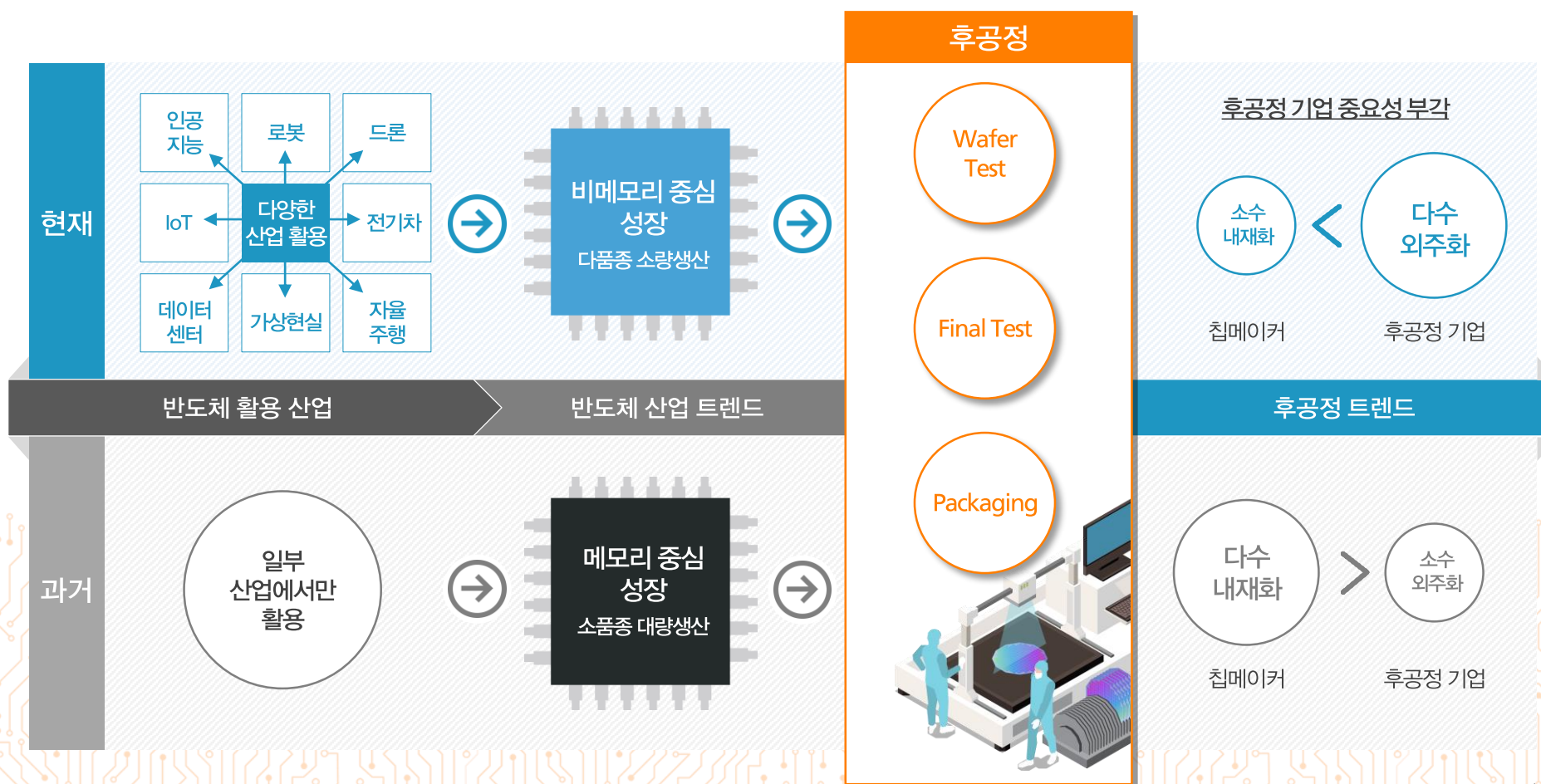
2. Core Competency

3. Growth Momentum

Appendix



혁신 산업 성장으로 다양한 비메모리 반도체 수요 증가 → 후공정 기업 수혜



비메모리 반도체 후공정 테스트 선도기업

차별화된 기술력



기술 기반 탄탄한 시장지위 구축

Wafer Test
(DDI, PM-IC, MCU 등)

Final Test
(DDI)

Packaging

기타 (Rim cut, COG, Recon)

안정적 파트너십



글로벌 Top기업 Reference

주요 고객사

SAMSUNG



견조한 재무성과



높은 성장성 및 수익성 확보

2023년 2Q 기준

매출액 142억 원
CAGR 20.1%
(‘20~’22년)

영업이익 (률)
65억 원 (24.6%)

01 Company Overview

1. 회사 개요
2. 사업영역
3. ALT 비메모리 반도체 공정 영역
4. 사업장 및 생산인프라



회사 개요

20년 업력의 비메모리 반도체 후공정 전문 기업



기업개요

회사명	(주) 에이엘티
대표이사	이덕형
설립일	2003년 7월 23일
자본금	40억 원
종업원수	179명
본점소재지	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19
홈페이지	www.alt-s.kr

대표이사



이덕형 CEO

- 서울대학교 물리학과 졸업, 이학박사
- 삼성전자(주) 근무 27년
- 삼성전자(주) 전무이사 역임
- LSI 공정개발 및 생산 총괄
- 삼성종합기술원 이미지링 소자 랩장/전무이사 역임
- 스텔코(주) 근무 3년
- 스텔코(주) 대표이사 역임
- 現 ALT 대표이사

지배구조 및 사업영역



80.05%



비메모리 후공정 테스트 사업 영위

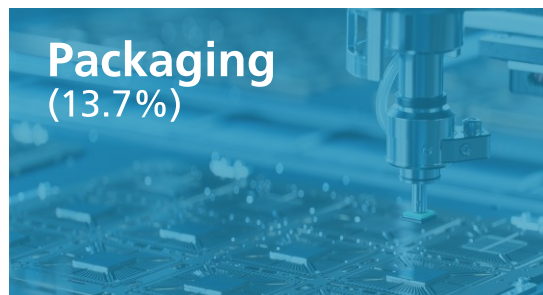
Wafer
TESTFinal
TESTRim cut
등

CIS 패키징 사업 영위

Packaging

OSAT(Wafer test + Packaging) 사업 기반 다양한 비메모리 반도체 후공정 업무 수행

매출구성 (2022년 기준)

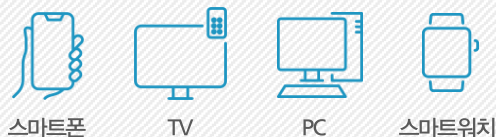


ALT 주요 비메모리 반도체

DDI (Display Driver IC)

각종 LCD Panel, LED, OLED 등을
구동 시키는 반도체 소자

적용 산업



CIS (CMOS Image Sensor)

빛에너지를 전기적인 신호로 변환하는
집적회로가 내장된 이미지 센서

적용 산업



PM-IC (IGBT 등)

전자기기에 필요한 전력
공급 및 효율적 관리

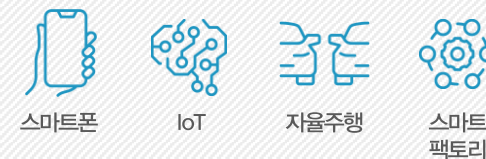
적용 산업



MCU / SoC

전자기기에 채택되는 통합 칩 (SoC)
단순 동작부터 AI 등 다양한 특성을 제어

적용 산업



ALT 비메모리 반도체 공정 영역

비메모리 반도체 후공정 토탈 솔루션 제공

■ ALT 사업 영역

전공정

후공정

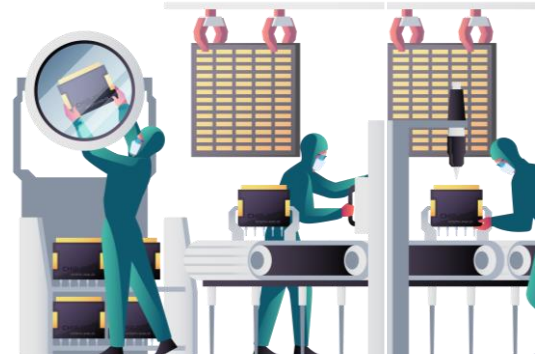
Wafer Test

Dicing / P&P

Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

사업 내용	웨이퍼 상태에서 양품/불량 판정	웨이퍼 절단 및 양품 재배열	패키징 공정	최종 출하 전 양품 판정
적용 제품	DDI CIS PM-IC (IGBT 등) MCU / SoC	Rim cut 웨이퍼 레이저 절단 IGBT COG 양품 재배열 DDI Recon Chip 불량 여부 파악 (신규사업) CIS	AGP 자회사 (주)에이지피 진행 CIS Wafer Test + Packaging OSAT 서비스 제공	DDI 

비메모리 반도체 후공정 Turnkey OSAT 제공

본사 (ALT + 자회사)

비메모리 반도체 Wafer Test부터 Packaging까지 생산에
최적화된 생산인프라



- 위치: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (오창과학산업단지)
- 비메모리 반도체 테스트 (ALT)
- 비메모리 반도체 패키징 (자회사)
- 건축면적: 12,348m²
- CAPA: 841억 원/년

신규 공장

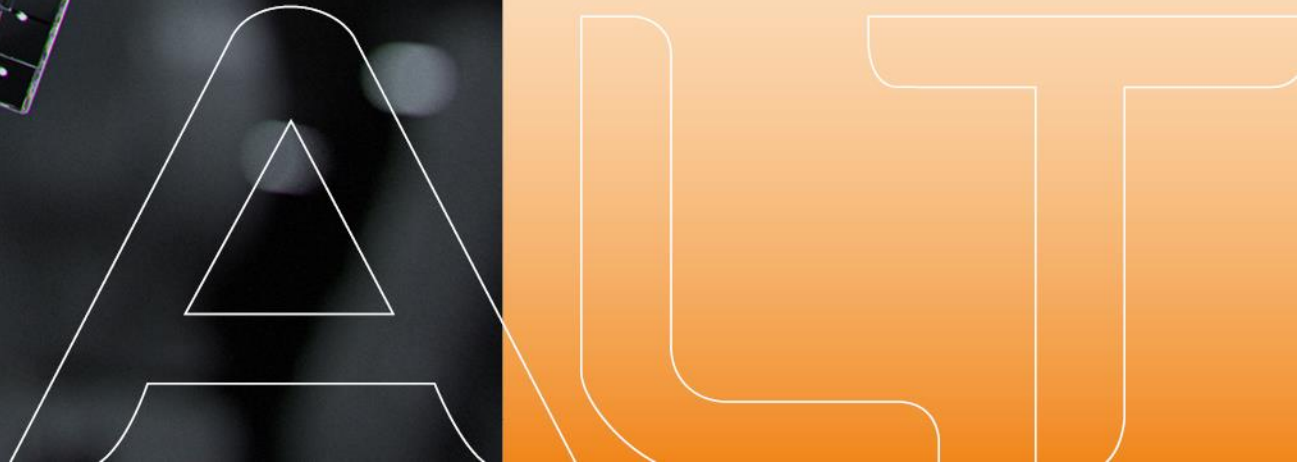
기존 사업 확장 및 Memory controller Wafer Test, AP Test 등의
신규 생산 인프라



- 위치: 오창테크노밸리 내
- 비메모리 반도체 테스트 (ALT)
- 비메모리 반도체 패키징 (자회사)
- 예정건축면적: 66,115m² (부지면적: 14,970m²)
- CAPA: 1,144억 원/년 (2025년 예정)

02 Core Competency

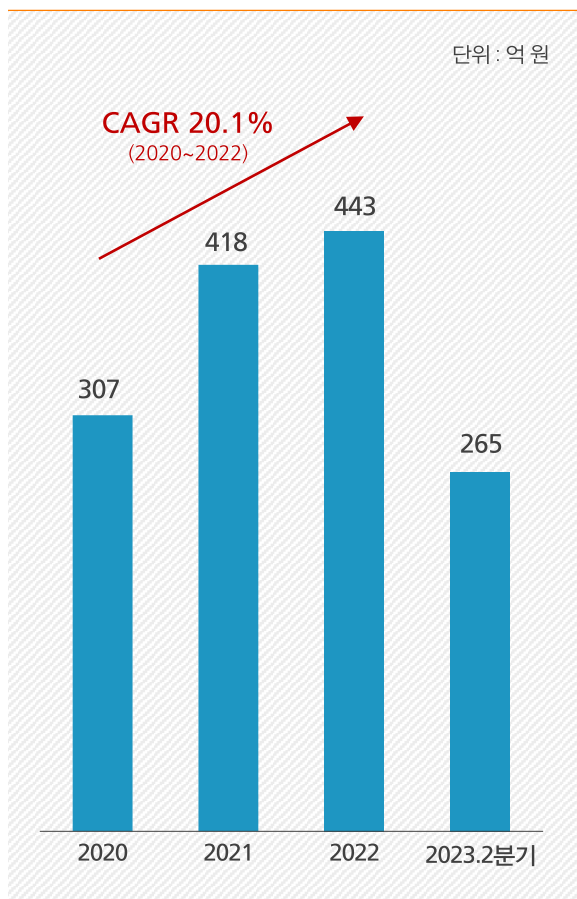
1. 압도적 경영성과
2. 다변화된 사업포트폴리오 구축
3. ALT's 차별화된 기술 제공
4. 고객 맞춤형 제품 생산의
최적화 솔루션 제공
5. 다양한 고객사 확보



압도적 경영성과

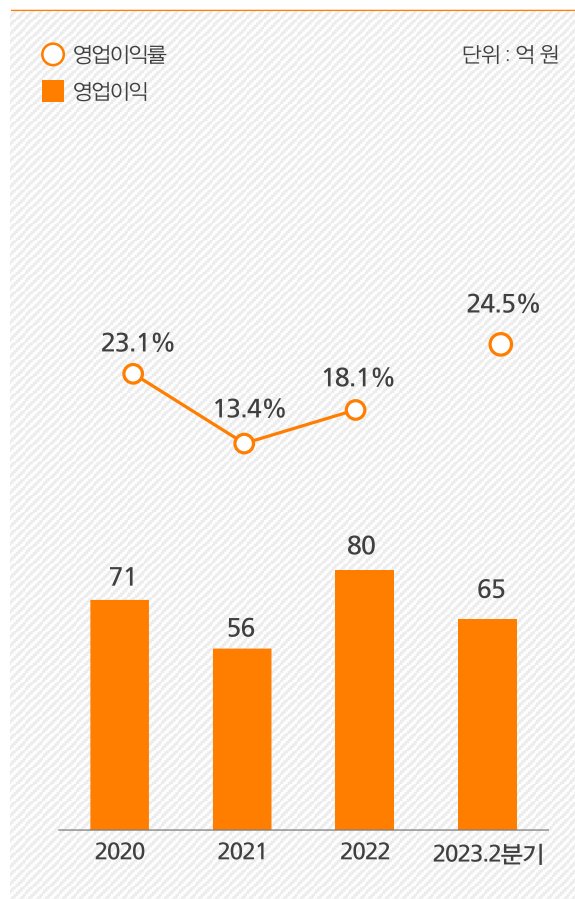
전방시장 성장(비메모리) 및 고객사 수요 증대로 폭발적인 성장 및 수익 창출

매출액



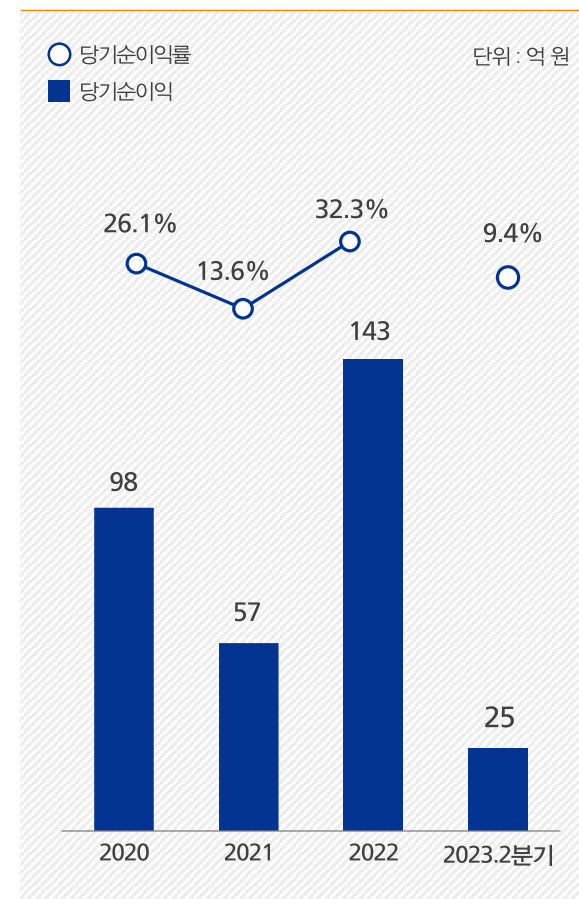
주: K-IFRS 연결 기준

영업이익(률)



주: K-IFRS 연결 기준

당기순이익(률)



주1: K-IFRS 연결 기준

주2: 2020년 법인세 38억 원, 2021년 법인세 1억 원,
2022년 법인세 35억 원 법인세 이익 효과에 따라 순이익 증가

다변화된 사업포트폴리오 구축

타사 대비 다변화된 비메모리 후공정 사업 포트폴리오를 통해 다양한 고객 니즈 대응 가능



사업 포트폴리오 구축



ALT Vs. Peers

구분	DDI	CIS	PM-IC (IGBT 등)	MCU / SoC
에이엘티	O	O	O	O
N사	O	X	O	O
D사	X	O	X	O
A사	X	X	X	O
G사	O	X	O	X
나사	X	O	O	O

ALT's 차별화된 기술 제공

PM-IC(IGBT 등) 웨이퍼 테스트 및 국내 유일 Rim Cut 기술을 Turnkey로 제공함으로써
고객만족도 제고



Rim cut (2021년 양산)

- 고전력 반도체 Thin Wafer 테두리를 *마이크로 폭으로 Sawing하는 기술



Rim cut 공정 후 Wafer

Full auto system 방식 Rim cut Process

*마이크로: 1/1,000mm

Rim cut 주요 장점

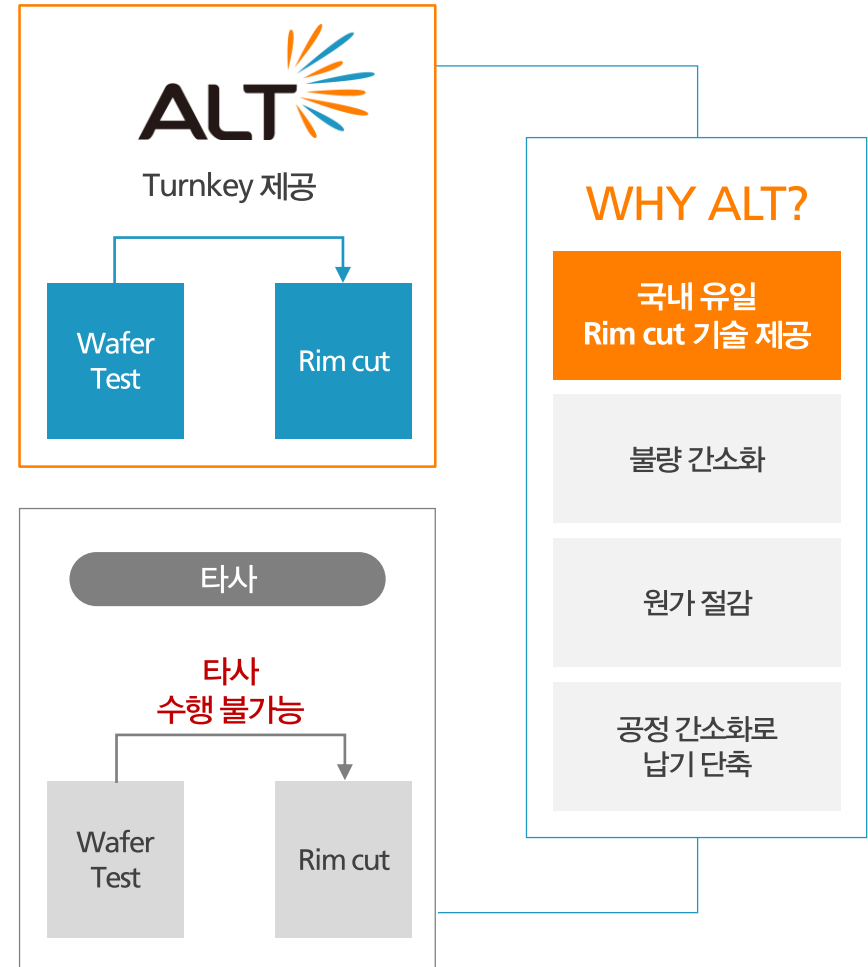
5개 공정을
Full auto system으로
데미지 최소화

Laser cut 방식으로
절단면 최소화

신기술 *Taiko Wafer
초정밀 Sawing

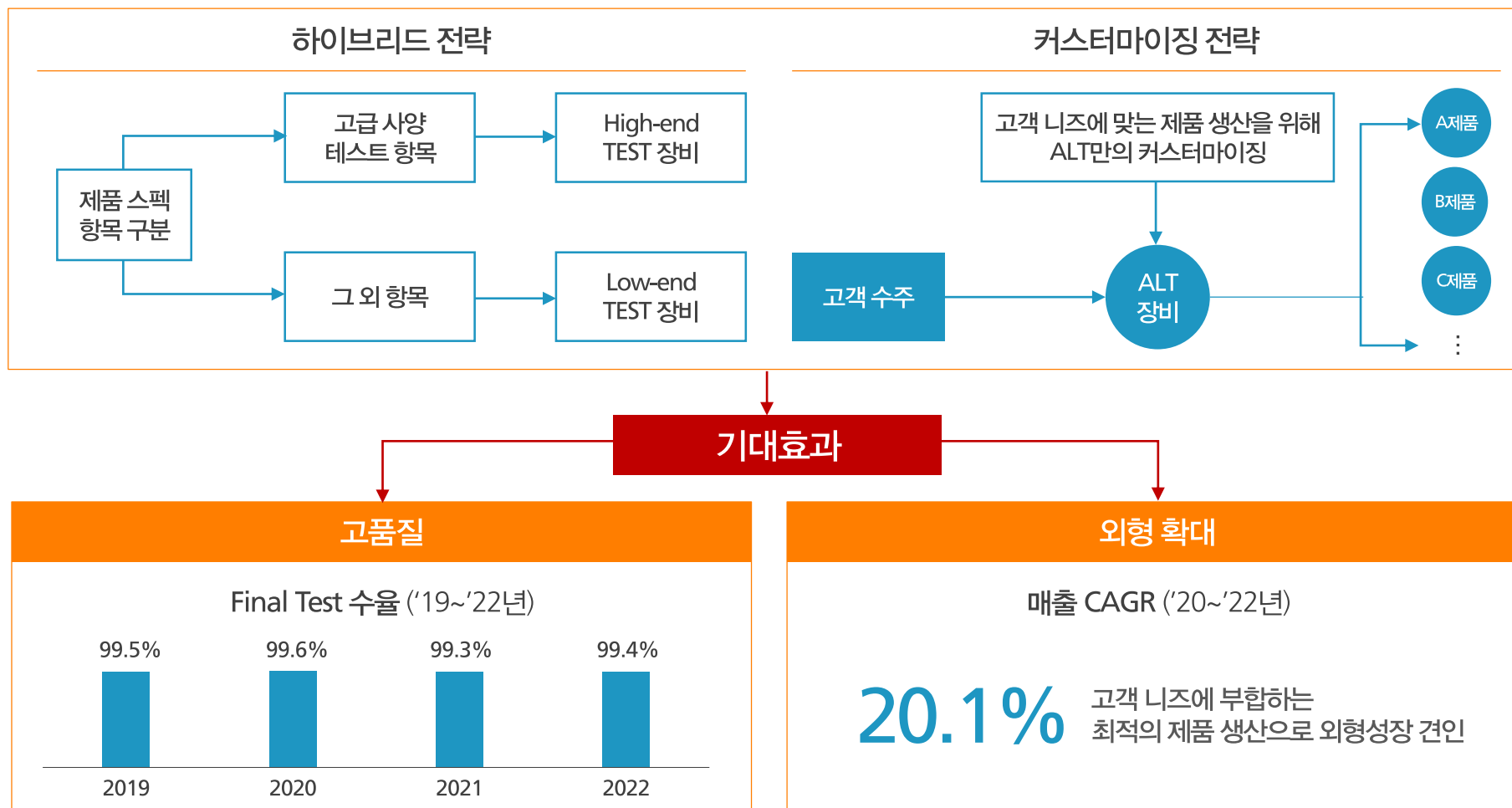
고객에게 더 많은 양품
Net Die 제공

*Taiko: 일정 폭의 얇은 테두리만 두껍게 남기고 나머지는 초박막으로 가공하는 기술



고객 맞춤형 제품 생산의 최적화 솔루션 제공

고객 수요에 맞는 ① 맞춤형 장비 배치 ② 장비 커스터మ్을 통해 고품질 제품 생산 및 외형 성장 견인

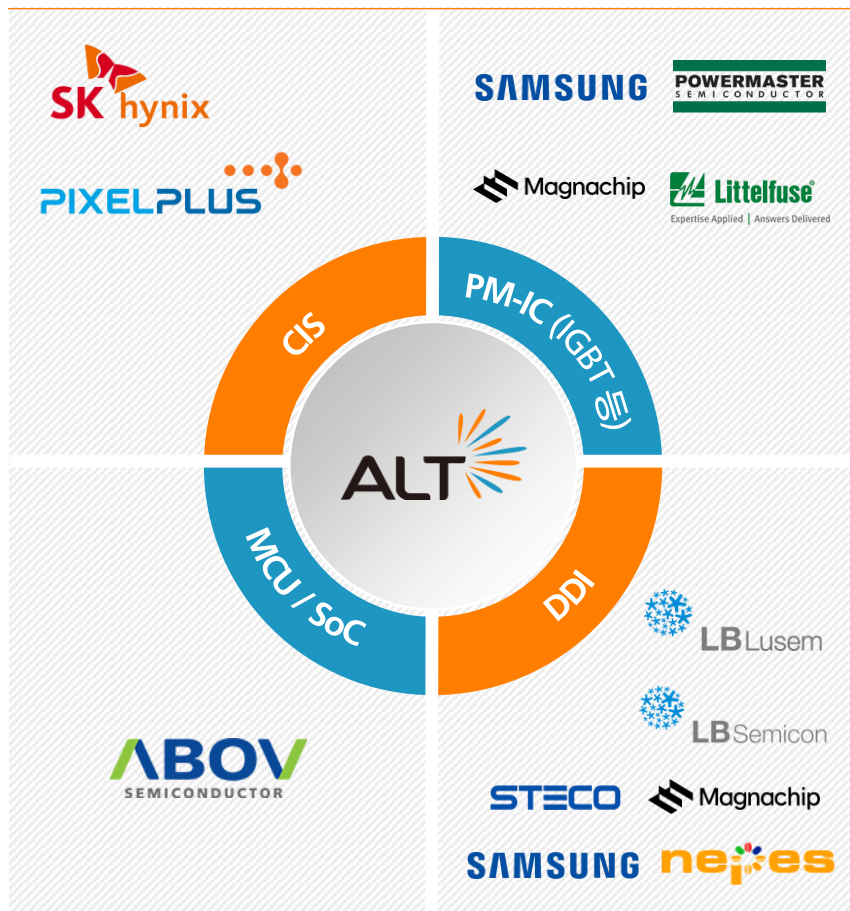


다양한 고객사 확보

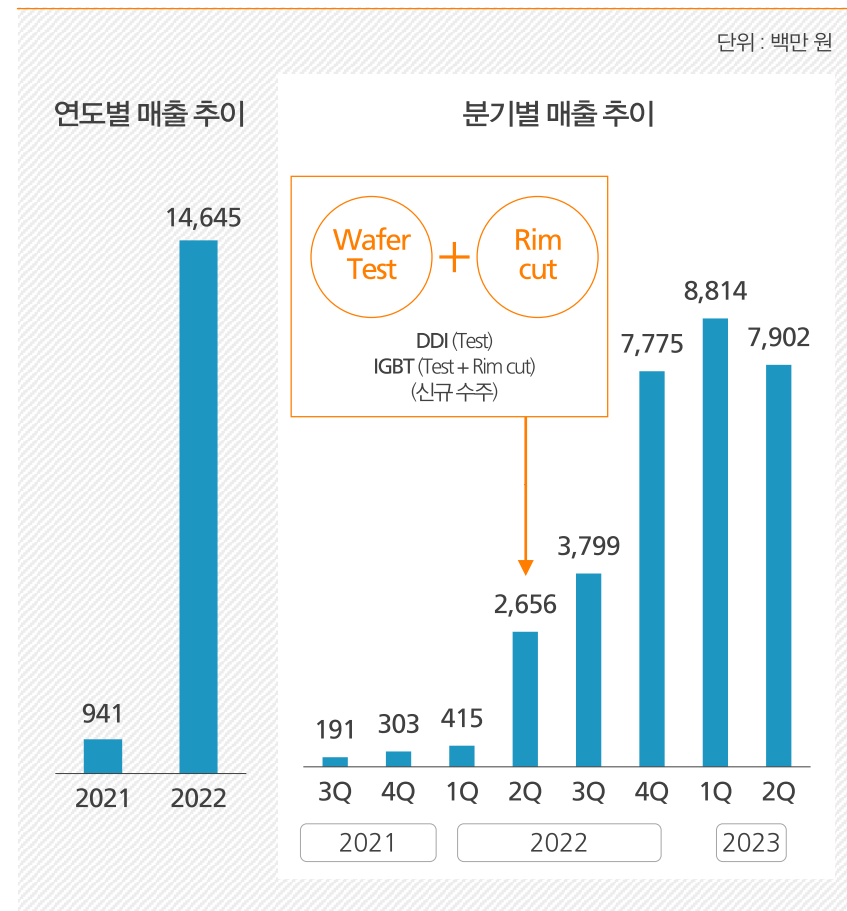
ALT만의 차별화된 기술 제공으로 다양한 고객사 확보



ALT 사업영역별 다양한 고객사



고객 A사向 매출 추이



03 Growth Momentum

성장로드맵

1. 비메모리반도체 시장 성장 (1), (2)
2. 기술 기반 기존 사업 확대 본격화
3. 신규 사업영역 확장
4. 선제적 기술 개발 추진
5. 신규 수주 기반 CAPA 확대

Vision

성장로드맵

신기술 개발 및 신규 수주 기반으로 지속적인 성장 모멘텀 확보



에이엘티 성장로드맵

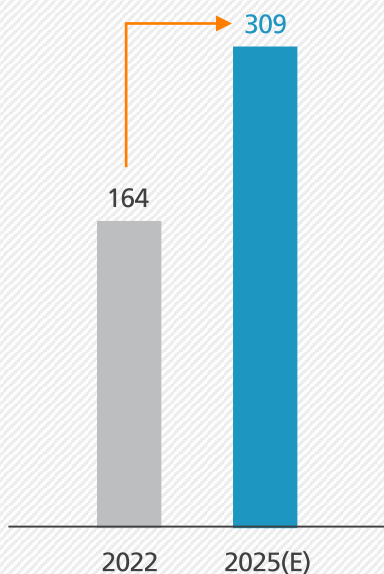


비메모리반도체 시장 성장 (1)

다양한 혁신 산업 지속 성장 → 비메모리 반도체 성장에 우호적인 환경 조성

글로벌 사물인터넷 시장

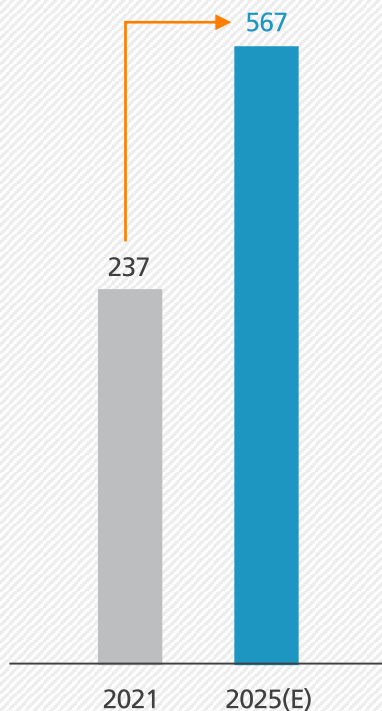
단위: 십억 달러



자료: IoT Analytics

글로벌 전기차 시장

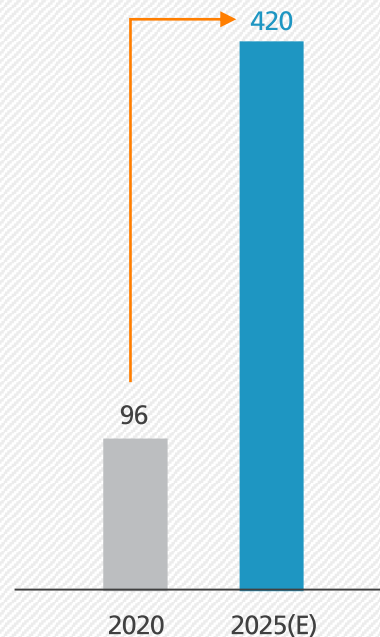
단위: 십억 달러



자료: Statista

글로벌 AI시장

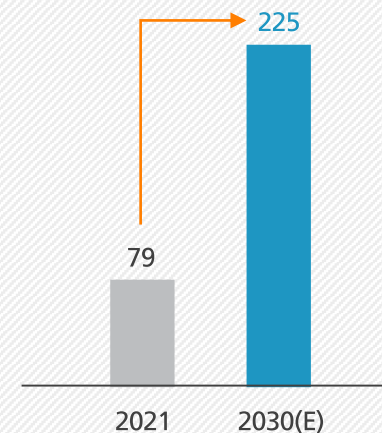
단위: 십억 달러



자료: Statista

글로벌 로봇 시장

단위: 억 달러

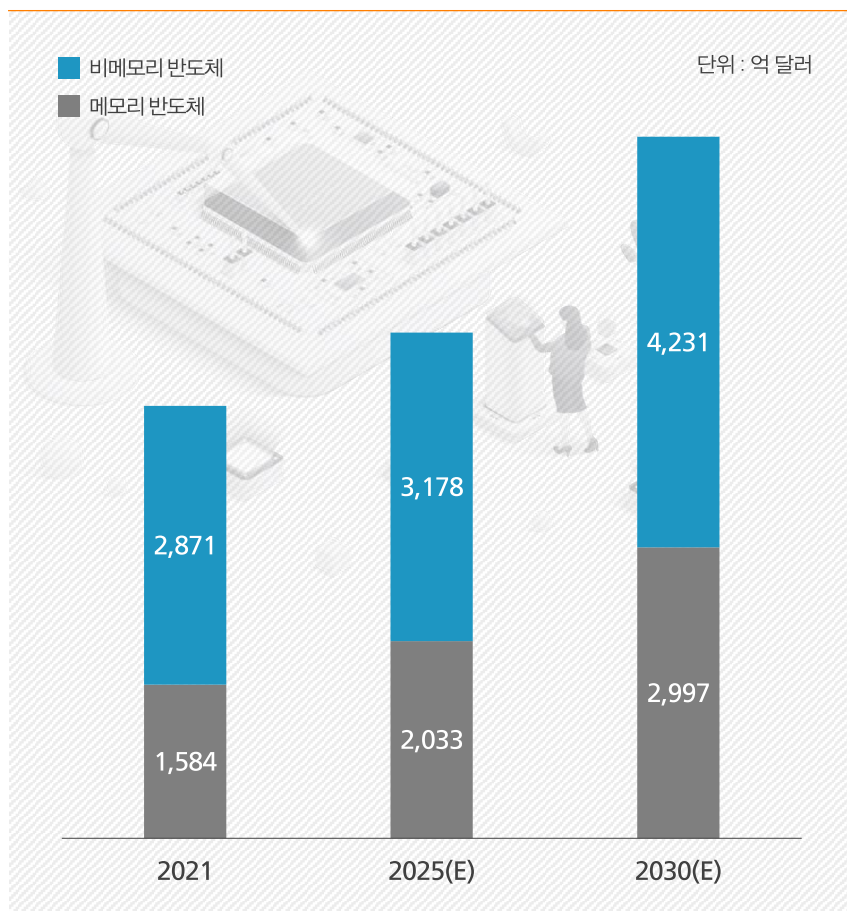


자료: 국제로봇연맹(IFR)

비메모리반도체 시장 성장 (2)

비메모리 반도체 시장의 지속 성장 속에서 국내 칩메이커 기업도 투자 확대

글로벌 반도체 시장 규모 및 전망



자료: 옴디아

국내 기업도 투자 증대

SAMSUNG

비메모리 반도체 투자 지속 확대

- 2042년까지 비메모리 반도체 300조원 투자
- 반도체+디스플레이 산업 60조원 투자
- 국내 710만㎡ 세계 최대 첨단 비메모리 반도체 클러스터 조성
- 첨단 반도체 제조공장 5개, 소부장 및 팹리스 등 150개 유치

자료: 한국무역협회(KITA), 언론 보도자료

SK hynix

비메모리 반도체 투자 확대

- 파운드리 기업 키파운드리 인수
- PMHC, DDI, CIS 등 비메모리 반도체 파운드리 사업 진행 중
- 향후 고부가 제품 트렌드에 맞춰 CIS 등 연구개발 인력 개편

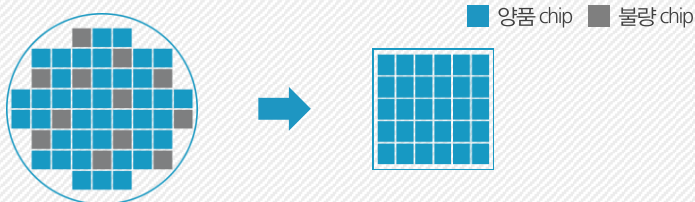
자료: 언론 보도자료

기술 기반 기존 사업 확대 본격화

Wafer Test외 양품 체크 및 성능별 칩 재배포 기술을 Turnkey로 제공해 사업 확장 실현

COG

DDI칩 Sawing 후 고객이 원하는 양품칩만을 Tray에 재배포하는 사업



COG 경쟁력

Wafer 사이즈별 재배포

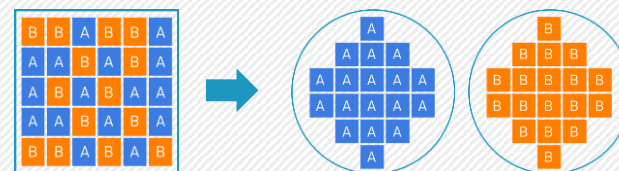
8인치, 12인치 웨이퍼,
*경박단소 필요제품 재배포 가능

고품질 생산 시스템 구축

Turnkey 서비스 제공
생산 표준화 MES 시스템 구축

Recon

Wafer Test 후 선별된 양품 Chip 성능별 구분 및 재배포



Recon 경쟁력

성능별 Chip 재배포

빠른 후속 공정 가능



One Stop 솔루션 제공

Test-Back Grinding
-Sawing-Recon

기대효과



1. 납기 단축

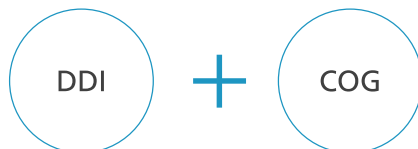


2. 수율 향상



3. 원가 절감

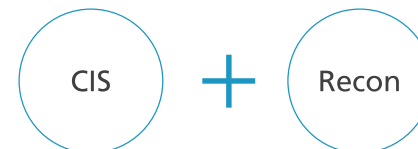
DDI 후공정 사업과 기술 시너지 기대



신규 고객사 지속 확보

비메모리 반도체 후공정 + 기술
포트폴리오 구축

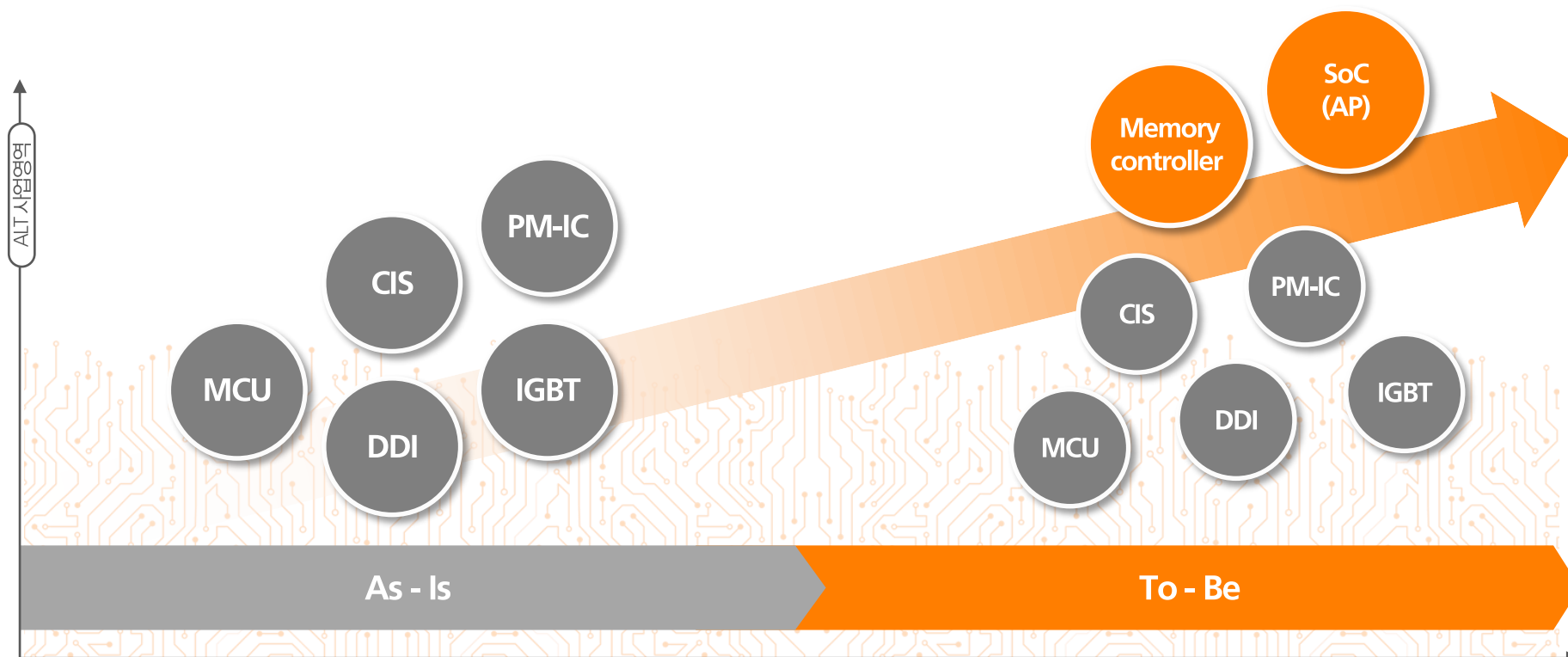
CIS 후공정 사업과 기술 시너지 기대



* 경박단소: 가법고, 얇고, 짧고, 작은 형태

신규 사업영역 확장

Memory controller, AP 등 신규 테스트 사업 대상 품목 확대



ALT 기술 경쟁력 구축
Rim Cut 기술 만족도 ↑
원가, 납기, 품질 만족도 ↑



IGBT, DDI A사 신규 수주



Memory controller
신규수주



AP 등 고부가가치
SoC 제품 확대

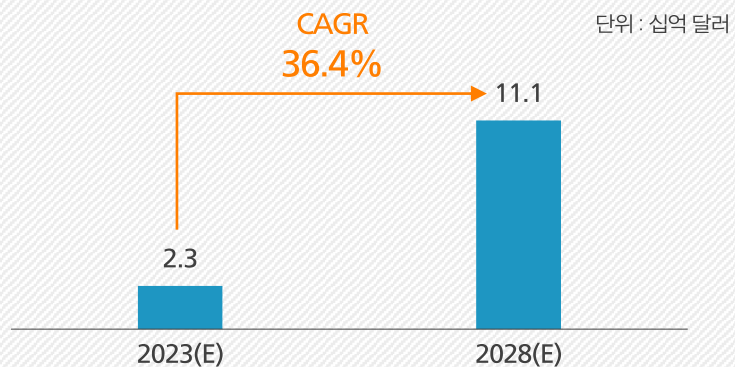
선제적 기술 개발 추진

차세대 전력반도체 (SiC 등) 신기술 개발로 시장 선점



SiC 차세대 전력 반도체 시장 전망

고온 고전압 환경에서 유리하고
전력 효율이 높은 SiC 반도체 수요증가
(신재생 에너지 발전설비 및 전기차에 주로 사용)



자료 : Markets and Markets

ALT Rim cut 신기술 개발 추진

Si 반도체에만 적용되는 ALT의 Rim cut 기술을
SiC 반도체에 응용하여 신규 개발 추진

2023(E)
기술 개발 완료



2024(E)
기술 상용화 추진

Si	구분	SiC
기술 상용화 완료	ALT Rim cut	기술 개발 추진
국내 유일	ALT Dicing 시장 포지션	기술 개발 완료 시 시장 선점 (국내 유일)

신규 수주 기반 CAPA 확대

고객사 수요 증가 기반 CAPA 투자 지속 확대

투자 계획 (공모자금 포함)

증설 투자

Memory controller
Wafer Test

CAPA 확대

DDI Wafer Test

신규 투자

AP Test

CAPA 확대

제2공장 신설

고객사 니즈 증가 기반
투자 지속 확대2025
공장 증설 매출 확대

2023

2024(E)

2025(E)

To-Be

Vision



비메모리 반도체 OSAT 선도기업



국내 비메모리 반도체 후공정 테스트 선도 기업

다변화된
사업포트폴리오 구축

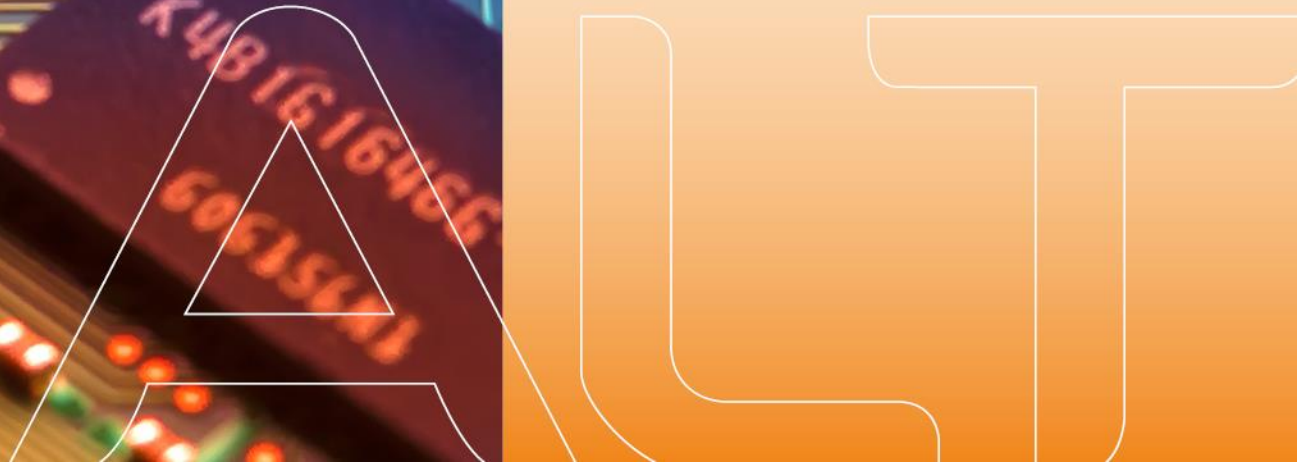
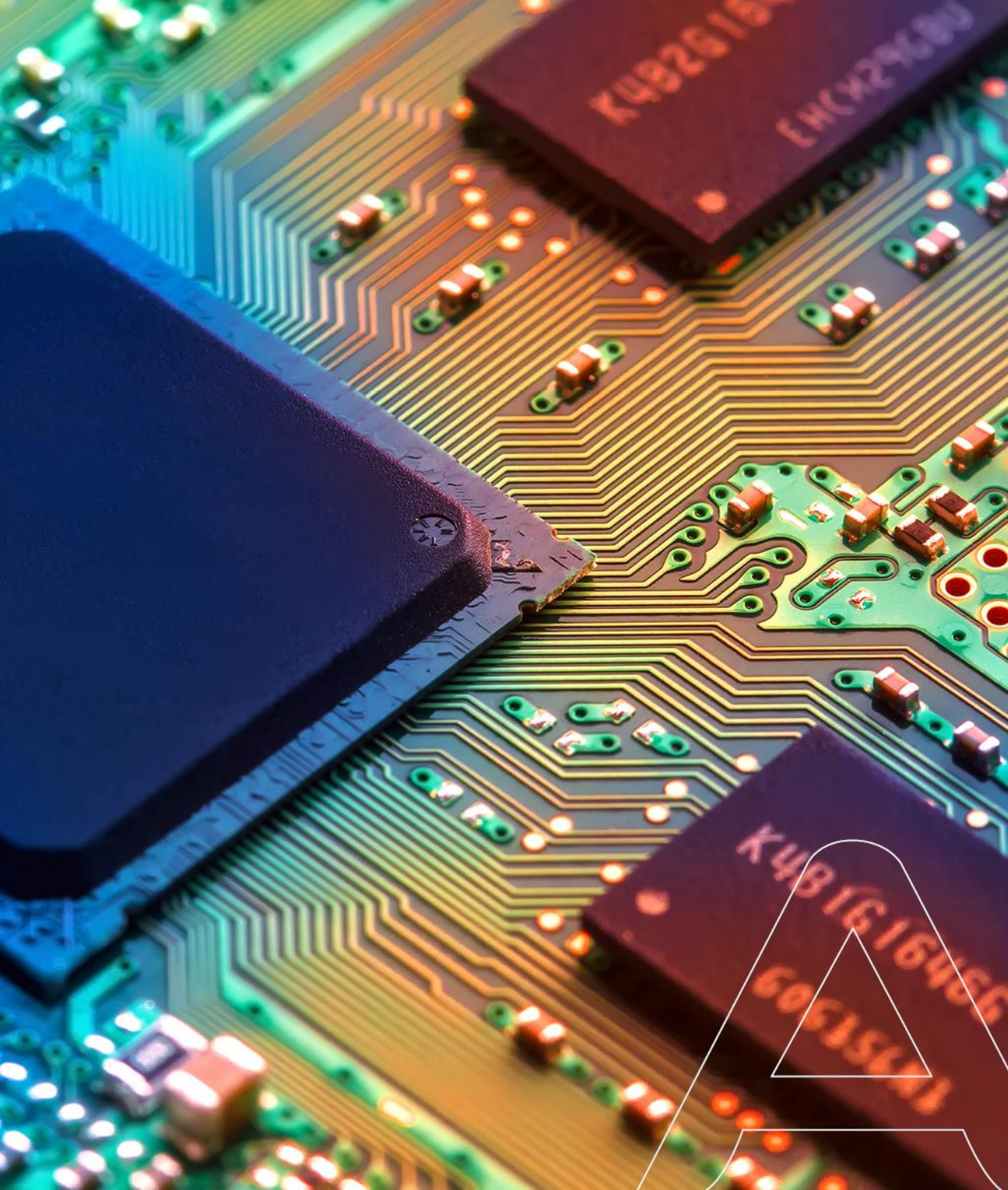
차별화된
기술력 구축

고객 맞춤형 제품 생산의
최적화 솔루션 제공

다양한
고객사 확보

04 Appendix

1. 요약 재무제표
2. 회사 연혁
3. 주요 용어설명





재무상태표

단위 : 백만 원

구분	2020년	2021년	2022년	2023.2분기
유동자산	6,243	10,129	13,508	10,352
비유동자산	107,216	102,603	170,372	174,977
자산총계	113,459	112,732	183,880	185,329
유동부채	42,414	17,708	62,708	47,849
비유동부채	43,467	39,175	51,819	66,359
부채총계	85,880	56,882	114,527	114,208
자본금	2,958	3,781	3,781	3,781
자본잉여금	2,834	24,459	24,459	24,459
자본조정	(1,202)	(984)	(984)	(984)
기타포괄손익 누계액	7,643	7,643	6,425	5,973
이익잉여금	15,346	19,677	34,922	37,225
자본총계	27,579	55,849	69,353	71,121

주: K-IFRS기준

손익계산서

단위 : 백만 원

구분	2020년	2021년	2022년	2023.2분기
매출액	30,699	41,842	44,319	26,481
매출원가	20,318	32,577	31,969	17,413
매출총이익	10,381	9,265	12,350	9,069
판매관리비	3,258	3,673	4,324	2,542
영업이익	7,123	5,592	8,026	6,526
금융수익	2,869	3,156	3,383	492
금융비용	4,497	3,760	2,846	6,383
기타수익	1,509	613	2,221	1,917
기타비용	1,075	25	—	1
법인세비용차감전 순이익	5,929	5,576	10,784	2,551
법인세비용	(3,844)	(106)	(3,476)	28
당기순이익	9,773	5,682	14,260	2,524

주: K-IFRS기준

사업기반 구축
(2003~2006)

- 2003**
- 에이엘티세미콘(주) 설립 (자본금 22.5억)
 - 2003년 (주)하이닉스 MOU 체결

- 2004**
- 공장 준공 (오창 과학산업단지)
 - 기업부설연구소 인가

- 2005**
- CIS (CMOS Image Sensor) 양산 시작

- 2006**
- 삼성전자(주) 물품 공급 계약 체결
 - (주)루셈 물품 공급 계약 체결

사업 고도화 및 성장기
(2007~2017)

- 2007**
- 08월 INNO-BIZ 선정
 - 12월 SK하이닉스(주) CIS 양산 시작

- 2008**
- 07월 건물 2,890평 증축 준공

- 2009**
- 01월 태진기술 PMHC 양산
 - 05월 Magna Chip 외 P/T 양산

- 2013**
- 07월 회사명 변경
(에이엘티세미콘(주) → (주)에이엘티)
 - 09월 지역전략산업 중소기업 선정

- 2015**
- 01월 스테코 DDI 양산 시작
 - 03월 제49회 납세자의 날
성실납세자 대통령 표창
 - 09월 CIS T2000 설비 투자 및 양산 시작

- 2016**
- 03월 DDI 12인치 Wafer P/T 양산 시작

- 2017**
- 11월 충청북도지사 일·생활균형 우수기업 인증

도약기
(2018~)

- 2018**
- 11월 삼성 PMHC (Wafer Test) 양산 시작

- 2019**
- 10월 제16회 충청북도
중소기업대상 수출대상
 - 11월 기술혁신형 중소기업 확인

- 2020**
- 02월 SK하이닉스 CIS 300mm (64para) 선정
 - 08월 중소벤처기업진흥공단
K-예비유니콘 유망기업
 - 08월 신규 Biz COG 양산 시작
 - 10월 충청북도 고용우수기업 인증

- 2021**
- 03월 ISO 14001:2015 인증 획득
 - 04월 IATF 16949:2016 인증 획득

- 2022**
- 03월 삼성 DDI, EDS P검 Biz 시작
 - 04월 준법경영위원회 설립
 - 09월 삼성 Memory controller
P검 설비 투자
 - 12월 투명경영위원회 설립